

# 2024-2030年中国印制电路 板（PCB）市场评估与投资潜力分析报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2024-2030年中国印制电路板（PCB）市场评估与投资潜力分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/412353.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，主要由绝缘基材与导体两类材料构成，在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。随着印刷电路板应用场景的不断拓展，下游产品不断创新，印刷电路板一般可分为刚性电路板、软性电路板、金属基电路板、HDI板和封装基板。

PCB行业的周期性受宏观经济波动的影响。随着电子信息产业的不断发展，PCB行业下游应用领域越来越广泛，涉及通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等众多领域。总体而言，PCB行业受单个行业波动影响较小，宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况对行业的影响较大。

从全球角度看，全球PCB行业下游应用领域广泛，因而受单一下游行业影响较小。2014-2021年全球印制电路板产值整体呈增长趋势。2021年，全球印制电路板市场规模约为804.49亿美元。当前，中国已成为全球最大PCB生产国，占全球PCB行业总产值的比例超过50%。从中国看，2020年，中国大陆PCB行业产值整体规模达350.09亿美元，占全球PCB行业总产值的比例为53.68%；2021年，中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了436.16亿美元，增幅24.59%。在我国印制电路板细分产品中，2020年，多层板市场占比最大，约为44.86%；其次是挠性板和HDI板，市场占比约为17.37%和17.34%。

在投融资方面，2021-2022年，PCB市场前景受新兴应用行业的引领，企业纷纷融资布局PCB生态链，加大企业PCB核心技术的研发，扩建生产线提升产能，为未来几年的PCB新应用市场做规划。圆周率半导体是一家电路板产品研发生产商，集研发、设计、制造和组装于一体，专注于生产和研发ATE、MLO、HDI和IC载板等电路板产品。2022年4月，圆周率半导体获得A轮融资，该轮融资由国发创投和凯胜创投参与投资。此前，2021年8月圆周率半导体获得元禾原点投资的天使轮融资。

2020年12月27日，国家发展和改革委员会公布《鼓励外商投资产业目录（2020年）》，将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路(线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ )柔性电路板”列入全国鼓励外商投资产业目录。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国印制电路板（PCB）市场评估与投资潜力分析报告》共十五章。首先介绍了PCB的定义、PCB的产业链等，接着对目前国内外PCB行业的发展做了解析，然后分析了PCB行业上游原料市场、中游产品以及下游应用领域的发展现状，并对国内PCB行业的地区。接着，报告对国内外PCB重点企业的运营状况做了分析。最后，报告对PCB的典型投资项目做了详细的介绍，并对其行业发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心、中国印制电路行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对PCB行业有个系统的了解、或者想投资PCB行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

报告目录：

## 第一章 印制电路板（PCB）概况

### 1.1 PCB介绍

#### 1.1.1 PCB定义

#### 1.1.2 PCB特征

#### 1.1.3 PCB应用领域分析

### 1.2 PCB产品链及产品分析

#### 1.2.1 PCB产业链

#### 1.2.2 PCB产品类型

#### 1.2.3 PCB主要产品

## 第二章 2021-2023年全球PCB行业发展情况综述

### 2.1 全球PCB产业发展现状全球PCB行业整体表现

#### 2.1.1 全球PCB产业规模状况

#### 2.1.2 全球PCB区域分布状况

#### 2.1.3 全球电子终端需求驱动

#### 2.1.4 全球PCB下游应用领域

#### 2.1.5 全球PCB主要厂商分布

#### 2.1.6 全球PCB市场空间预测

### 2.2 全球PCB行业主要产品市场发展格局

#### 2.2.1 挠性板

#### 2.2.2 多层板

#### 2.2.3 HDI板

#### 2.2.4 封装基板

### 2.3 PCB行业主要国家发展分析

#### 2.3.1 美国PCB行业发展

#### 2.3.2 日本PCB行业发展

### 2.3.3 韩国PCB行业发展

## 第三章 2021-2023年中国PCB行业发展环境分析

### 3.1 宏观经济环境

#### 3.1.1 宏观经济概况

#### 3.1.2 对外经济分析

#### 3.1.3 工业运行情况

#### 3.1.4 固定资产投资

#### 3.1.5 宏观经济展望

### 3.2 电子信息制造业运行情况

#### 3.2.1 总体运营情况

#### 3.2.2 固定资产投资

#### 3.2.3 通信设备制造业

#### 3.2.4 电子元件制造业

#### 3.2.5 电子器件制造业

#### 3.2.6 计算机制造业

### 3.3 PCB行业政策环境

#### 3.3.1 行业规范条件

#### 3.3.2 产业结构目录

#### 3.3.3 环保政策影响

## 第四章 2021-2023年中国PCB行业市场运行情况

### 4.1 中国PCB行业市场发展情况

#### 4.1.1 PCB行业市场规模

#### 4.1.2 PCB行业产业转移

#### 4.1.3 PCB细分产品结构

#### 4.1.4 PCB下游应用市场

### 4.2 中国PCB行业竞争格局

#### 4.2.1 PCB企业竞争格局

#### 4.2.2 PCB产业集群分布

#### 4.2.3 内资企业发展现状

#### 4.2.4 PCB企业融资情况

- 4.2.5 行业规范条件符合企业
- 4.2.6 PCB企业集中发展趋势
- 4.3 PCB行业技术热点
  - 4.3.1 制造技术提升
  - 4.3.2 设计重要性突显
  - 4.3.3 基板材料高性能化
  - 4.3.4 高性能要求高可靠
- 4.4 PCB行业主要进入壁垒分析
  - 4.4.1 资金壁垒
  - 4.4.2 技术壁垒
  - 4.4.3 环保壁垒
  - 4.4.4 客户认可壁垒

## 第五章 2021-2023年中国柔性电路板（FPC）发展情况分析

- 5.1 柔性电路板（FPC）概述
  - 5.1.1 FPC产品介绍
  - 5.1.2 FPC制备流程
  - 5.1.3 FPC发展进程
  - 5.1.4 FPC应用领域
- 5.2 FPC市场运行情况分析
  - 5.2.1 FPC行业市场规模
  - 5.2.2 FPC行业供需状况
  - 5.2.3 FPC行业应用规模
  - 5.2.4 FPC产品市场价格
  - 5.2.5 FPC行业集中度
  - 5.2.6 FPC行业竞争格局
  - 5.2.7 国内厂商发展情况
  - 5.2.8 FPC产业转移进程
- 5.3 FPC应用领域发展分析
  - 5.3.1 单机FPC价值量
  - 5.3.2 射频天线创新需求
  - 5.3.3 汽车FPC应用

#### 5.3.4 工控医疗应用

### 第六章 2021-2023年PCB行业上游原材料市场运行分析

#### 6.1 PCB行业上游原材料简析

#### 6.2 PCB用铜箔市场分析

##### 6.2.1 铜箔概况

##### 6.2.2 市场需求

##### 6.2.3 价格走势

##### 6.2.4 产能规模

#### 6.3 PCB玻纤市场发展情况

##### 6.3.1 玻纤材料介绍

##### 6.3.2 玻纤性能要求

##### 6.3.3 玻纤需求分析

##### 6.3.4 玻纤市场现状

##### 6.3.5 市场进入壁垒

#### 6.4 PCB其他原料发展分析

##### 6.4.1 PCB油墨

##### 6.4.2 PCB化学品

##### 6.4.3 PCB磷铜球

### 第七章 2021-2023年PCB行业中游市场分析——覆铜板

#### 7.1 覆铜板概述

##### 7.1.1 覆铜板介绍

##### 7.1.2 覆铜板分类

##### 7.1.3 生产工艺流程

#### 7.2 覆铜板主要产品发展情况

##### 7.2.1 刚性覆铜板

##### 7.2.2 挠性覆铜板

##### 7.2.3 半固化片

#### 7.3 覆铜板市场运行情况

##### 7.3.1 市场运行情况

##### 7.3.2 市场需求情况

- 7.3.3 行业竞争格局
- 7.3.4 行业进入壁垒
- 7.3.5 行业发展趋势
- 7.4 2021-2023年中国印制电路用覆铜板进出口数据分析
  - 7.4.1 进出口总量数据分析
  - 7.4.2 主要贸易国进出口情况分析
  - 7.4.3 主要省市进出口情况分析

## 第八章 2021-2023年PCB行业下游应用领域——消费电子

- 8.1 消费电子及相关PCB产品应用分析
  - 8.1.1 消费电子市场发展现状
  - 8.1.2 消费电子PCB要求
  - 8.1.3 消费电子PCB市场
  - 8.1.4 PCB厂商业务布局
- 8.2 类载板（SLP）发展情况分析
  - 8.2.1 SLP发展进程
  - 8.2.2 手机SLP价值
  - 8.2.3 技术发展趋势
- 8.3 消费电子PCB发展市场空间
  - 8.3.1 5G手机用板需求
  - 8.3.2 SLP市场发展空间
  - 8.3.3 智能穿戴设备应用

## 第九章 2021-2023年PCB行业下游应用领域——汽车电子

- 9.1 汽车电子行业发展综述
  - 9.1.1 汽车电子概念
  - 9.1.2 汽车电子分类
  - 9.1.3 汽车电子产业链
  - 9.1.4 汽车电子成本占比
- 9.2 汽车领域PCB应用介绍
  - 9.2.1 汽车用PCB需求
  - 9.2.2 汽车用PCB种类

- 9.2.3 PCB汽车应用领域
- 9.2.4 汽车PCB价值分析
- 9.3 汽车PCB市场运行情况
  - 9.3.1 产业市场规模
  - 9.3.2 企业产品布局
  - 9.3.3 企业发展格局
- 9.4 汽车PCB发展市场空间分析
  - 9.4.1 车用PCB价值量简析
  - 9.4.2 新能源汽车PCB应用
  - 9.4.3 汽车智能化PCB需求

## 第十章 2021-2023年PCB行业下游应用领域——通信设备

- 10.1 通讯设备发展情况
  - 10.1.1 4G基站设备PCB应用
  - 10.1.2 中国5G建设现状简析
  - 10.1.3 5G基站PCB市场空间
  - 10.1.4 基站的PCB用量对比
- 10.2 通讯领域PCB应用分析
  - 10.2.1 通讯领域PCB应用
  - 10.2.2 通信PCB产品需求
- 10.3 通信领域PCB市场运营情况
  - 10.3.1 市场规模分析
  - 10.3.2 竞争格局分析
  - 10.3.3 企业发展状况
- 10.4 通信领域PCB行业进入壁垒分析
  - 10.4.1 技术壁垒
  - 10.4.2 投资壁垒
  - 10.4.3 认证壁垒

## 第十一章 2021-2023年中国PCB行业地区发展情况综述

- 11.1 台湾地区PCB发展简析
  - 11.1.1 台湾PCB进出口情况

- 11.1.2 台湾PCB市场规模
- 11.1.3 台湾PCB厂商营收
- 11.1.4 台湾PCB发展蓝图
- 11.1.5 台湾PCB智慧制造
- 11.1.6 台湾PCB智慧发展
- 11.2 广东省PCB行业发展分析
  - 11.2.1 PCB行业发展格局
  - 11.2.2 PCB行业相关政策
  - 11.2.3 PCB项目融资动态
  - 11.2.4 PCB智能制造试点
- 11.3 江西省PCB行业发展分析
  - 11.3.1 地区发展现状
  - 11.3.2 行业政策规划
  - 11.3.3 项目建设动态

## 第十二章 中国PCB行业项目投资建设案例深度解析

- 12.1 柔性多层印制电路板扩产项目
  - 12.1.1 项目基本概述
  - 12.1.2 投资价值分析
  - 12.1.3 建设内容规划
  - 12.1.4 资金需求测算
  - 12.1.5 实施进度安排
  - 12.1.6 经济效益分析
- 12.2 高阶HDI印制电路板扩产项目
  - 12.2.1 项目基本概述
  - 12.2.2 投资价值分析
  - 12.2.3 建设内容规划
  - 12.2.4 资金需求测算
  - 12.2.5 实施进度安排
  - 12.2.6 经济效益分析
- 12.3 挠性印制电路板建设项目
  - 12.3.1 项目基本概述

- 12.3.2 投资价值分析
- 12.3.3 资金需求测算
- 12.3.4 实施进度安排
- 12.3.5 项目效益分析

## 第十三章 2020-2023年国外PCB重点企业发展分析

### 13.1 旗胜 (Nippon Mektron)

- 13.1.1 企业发展概况
- 13.1.2 企业布局动态
- 13.1.3 2021财年企业经营状况分析
- 13.1.4 2022财年企业经营状况分析
- 13.1.5 2023财年企业经营状况分析

### 13.2 迅达 (TTM)

- 13.2.1 企业发展概况
- 13.2.2 2021财年企业经营状况分析
- 13.2.3 2022财年企业经营状况分析
- 13.2.4 2023财年企业经营状况分析

### 13.3 三星电机

- 13.3.1 企业发展概况
- 13.3.2 2021年企业经营状况分析
- 13.3.3 2022年企业经营状况分析
- 13.3.4 2023年企业经营状况分析

### 13.4 藤仓 (Fujikura)

- 13.4.1 企业发展概况
- 13.4.2 2021财年企业经营状况分析
- 13.4.3 2022财年企业经营状况分析
- 13.4.4 2023财年企业经营状况分析

## 第十四章 2020-2023年中国PCB重点企业发展分析

### 14.1 健鼎科技股份有限公司

- 14.1.1 企业发展概况
- 14.1.2 2021年企业经营状况分析

- 14.1.3 2022年企业经营状况分析
- 14.1.4 2023年企业经营状况分析
- 14.2 欣兴电子股份有限公司
  - 14.2.1 企业发展概况
  - 14.2.2 2021年企业经营状况分析
  - 14.2.3 2022年企业经营状况分析
  - 14.2.4 2023年企业经营状况分析
- 14.3 深南电路股份有限公司
  - 14.3.1 企业发展概况
  - 14.3.2 企业业务布局
  - 14.3.3 经营效益分析
  - 14.3.4 业务经营分析
  - 14.3.5 财务状况分析
  - 14.3.6 核心竞争力分析
  - 14.3.7 公司发展战略
  - 14.3.8 未来前景展望
- 14.4 深圳市景旺电子股份有限公司
  - 14.4.1 企业发展概况
  - 14.4.2 企业经营模式
  - 14.4.3 经营效益分析
  - 14.4.4 业务经营分析
  - 14.4.5 财务状况分析
  - 14.4.6 核心竞争力分析
  - 14.4.7 公司发展战略
  - 14.4.8 未来前景展望
- 14.5 东山精密制造股份有限公司
  - 14.5.1 企业发展概况
  - 14.5.2 企业业务布局
  - 14.5.3 经营效益分析
  - 14.5.4 业务经营分析
  - 14.5.5 财务状况分析
  - 14.5.6 核心竞争力分析

- 14.5.7 公司发展战略
- 14.5.8 未来前景展望
- 14.6 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
  - 14.6.1 企业发展概况
  - 14.6.2 主要业务发展
  - 14.6.3 企业研发投入
  - 14.6.4 经营效益分析
  - 14.6.5 业务经营分析
  - 14.6.6 财务状况分析
  - 14.6.7 核心竞争力分析
  - 14.6.8 公司发展战略
  - 14.6.9 未来前景展望
- 14.7 沪士电子股份有限公司
  - 14.7.1 企业发展概况
  - 14.7.2 主要业务发展
  - 14.7.3 经营效益分析
  - 14.7.4 业务经营分析
  - 14.7.5 财务状况分析
  - 14.7.6 核心竞争力分析
  - 14.7.7 公司发展战略
  - 14.7.8 未来前景展望

## 第十五章 2024-2030年PCB行业投资分析及前景预测

- 15.1 PCB行业投资分析
  - 15.1.1 行业投资态势
  - 15.1.2 企业投资动态
  - 15.1.3 企业投资机遇
- 15.2 PCB行业发展前景分析
  - 15.2.1 PCB产业链布局方向
  - 15.2.2 5G基站PCB业务前景
  - 15.2.3 HDI产品发展机遇
  - 15.2.4 汽车PCB市场空间

## 15.2.5 PCB智能工厂前景

## 15.3 对2024-2030年中国PCB行业预测分析

### 15.3.1 2024-2030年中国PCB行业影响因素分析

### 15.3.2 2024-2030年中国PCB产值预测

### 15.3.3 2024-2030年中国柔性电路板市场规模预测

## 附录

### 附录一：印制电路板行业规范条件

## 图表目录

图表1 PCB在下游各领域中的运用

图表2 PCB产业链

图表3 按客户的不同阶段需求分类

图表4 样板与批量板对比

图表5 PCB分类（按基材柔软性）

图表6 PCB产品按导电涂层数分类

图表7 PCB产品按技术发展方向分类

图表8 多层板分类

图表9 HDI板生产工艺要求

图表10 封装基板按技术分类

图表11 2014-2019年全球PCB产值及增长速度

图表12 2019年全球PCB产值地区分布

图表13 2020年全球前40大PCB厂商季度营收增速（一）

图表14 2020年全球前40大PCB厂商季度营收增速（二）

图表15 2020年全球前40大PCB厂商季度营收增速（三）

图表16 2019年全球PCB下游应用领域分布

图表17 2019年全球PCB厂商TOP10

图表18 2020-2025年全球PCB产值预测

图表19 2019-2024年全球PCB各类板块产值情况及预测

图表20 2019-2024年全球PCB各类型产值复合增速预测

图表21 FPC全球产值

图表22 多层板产值细分

图表23 中低层板和高层板产值

图表24 HDI产值与PCB总产值增长率对比

图表25 2010-2023全球封装基板产值

图表26 2015-2019年国内生产总值及其增长速度

图表27 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表28 2015-2019年货物进出口总额

图表29 2019年货物进出口总额及其增长速度

图表30 2019年主要商品出口数量、金额及其增长速度

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/412353.html>